

管理計画(WLP-20-01)
CONTROL PLAN(WLP-20-01)

トレックス・セミコンダクター株式会社
TOIREX SEMICONDUCTOR LTD.

代表例

工程記号 Flow	No	工程名 Process	主な管理項目 Major item checked	頻度 Frequency	プロセス Process
◇	1	材料&部品受入 Material & Parts incoming	ウエハ、マスク 検査 Wafer, Mask check		ウエハ工程(外注) Wafer process
○	2	拡散/イオン注入 Drive / Ion implantation	表面検査, 酸化膜厚測定 Surface check, OX thickness measurement	抜き取り Sampling	
○	3	フォト / エッチング Photo / Etching	表面検査, パターン検査 Surface check, Patern check	抜き取り Sampling	
○	4	配線 Metallization	表面検査, 膜厚 & 抵抗測定 Surface check, Thickness & Resistance measurement	抜き取り Sampling	
○	5	パッシベーション Passivation film	表面検査, 膜厚測定 Surface checke, Thickness measurement	抜き取り Sampling	
◇	6	プローブ試験 Probe test	電気的特性 Electrical characteristics	100% 100%	
◇	7	ウエハ出荷検査 Wafer out going inspection	表面検査 Surface checke	抜き取り Sampling	
○	8	ポリイミド膜形成 Polyimide coating	表面検査, 膜厚測定 Surface checke, Thickness measurement	抜き取り Sampling	組立工程(外注) Assembly process
○	9	再配線形成 Re-distribution deposition	表面検査, 再配線寸法検査 Surface checke, Dimension check	抜き取り Sampling	
○	10	ポスト形成 Post deposition	表面検査, ポスト寸法検査 Surface checke, Dimension check	抜き取り Sampling	
◇	11	中間検査 Interlevel check	表面検査 Surface check	抜き取り Sampling	
○	12	封止 Encapsulation	外観 Visual check	抜き取り Sampling	
○	13	バックグラインド Back grind	外観 Visual check	抜き取り Sampling	
○	14	マーキング Marking	外観 Visual check	抜き取り Sampling	
○	15	ボール搭載 Solder ball mount	外観 Visual check	抜き取り Sampling	
◇	16	外観検査 Visual check	表面検査 Surface check	抜き取り Sampling	
◇	17	最終試験 Final test	直流, 交流特性及び機能試験 DC, AC characteristics & Function test	100% 100%	最終試験工程(外注) Final Test Process
○	18	ダイシング Dicing	外観 Visual check	抜き取り Sampling	
◇	19	外観検査 Visual check	外観 Visual check	100% 100%	
○	25	テーピング Taping	外観 Appearanc テーピング強度 Taping strength	100% 100% 1回/材料ロット Per material lot	
◇	20	出荷検査 Out going inspection	外観 Visual check	抜き取り Sampling	